



2024年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2024年3月29日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
コード番号 8155 URL <https://www.mimasu.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 八高 達郎
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部 本部長 (氏名) 中島 孝之 (TEL) 027-372-2021
四半期報告書提出予定日 2024年4月12日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年5月期第3四半期の業績(2023年6月1日～2024年2月29日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年5月期第3四半期	64,703	△6.5	9,054	△7.7	9,057	△6.8	6,347	△5.7
2023年5月期第3四半期	69,199	27.0	9,812	49.4	9,721	47.4	6,731	49.0

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年5月期第3四半期	197.58	-
2023年5月期第3四半期	209.54	-

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年5月期第3四半期	116,331	80,754	69.4
2023年5月期	124,339	76,396	61.4

(参考)自己資本 2024年5月期第3四半期 80,754百万円 2023年5月期 76,396百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年5月期	-	32.00	-	32.00	64.00
2024年5月期	-	32.00	-	-	-
2024年5月期(予想)	-	-	-	32.00	64.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年5月期の業績予想(2023年6月1日～2024年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	86,000	△5.4	10,300	△7.8	10,150	△7.7	7,030	△7.7	218.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年5月期3Q	35,497,183株	2023年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2024年5月期3Q	3,373,302株	2023年5月期	3,373,211株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年5月期3Q	32,123,945株	2023年5月期3Q	32,124,373株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な資源価格高騰や海外経済の下振れなどの影響を受けたものの設備投資や個人消費が持ち直すなど、全体として緩やかな回復基調が継続しました。

半導体シリコンウエハの生産は引き続きデバイス市場における在庫調整の影響を受けましたが、当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は底堅く推移しました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は647億3百万円と前年同四半期比6.5%の減収となり、営業利益は90億5千4百万円(前年同四半期比7.7%減)、経常利益は90億5千7百万円(同6.8%減)、四半期純利益は63億4千7百万円(同5.7%減)となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。なお、売上高及び利益には、セグメント間の内部取引に係る金額が含まれています。

半導体事業部

当事業部はデバイス市場における在庫調整の影響を受けました。

この結果、当事業部の売上高は352億6千2百万円(前年同四半期比14.9%減)、セグメント利益(営業利益)は69億8千4百万円(同9.0%減)となりました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

この結果、その他の取扱商品において増収となり、当事業部の売上高は307億4千5百万円(前年同四半期比8.9%増)、セグメント利益(営業利益)は18億6百万円(同6.8%増)となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売しました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は40億7百万円(前年同四半期比29.8%減)、セグメント利益(営業利益)は5億6千1百万円(同25.5%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により、前事業年度末と比較して80億8百万円減少し、1,163億3千1百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により123億6千5百万円減少し、355億7千7百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加42億9千1百万円等により、807億5千4百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2023年9月29日に公表した業績予想に変更はありません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2024年2月29日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,240	21,223
受取手形及び売掛金	40,063	31,770
商品及び製品	4,692	3,410
仕掛品	1,370	1,218
原材料及び貯蔵品	4,347	4,944
その他	3,349	965
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	81,059	63,529
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	21,502	20,375
機械及び装置（純額）	8,461	8,721
建設仮勘定	3,298	13,743
その他（純額）	4,521	5,333
有形固定資産合計	37,783	48,173
無形固定資産	809	807
投資その他の資産	4,687	3,821
固定資産合計	43,280	52,802
資産合計	124,339	116,331
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	30,919	26,657
未払法人税等	3,172	—
引当金	110	528
その他	13,533	7,793
流動負債合計	47,735	34,978
固定負債		
退職給付引当金	41	—
その他	166	598
固定負債合計	207	598
負債合計	47,943	35,577

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2024年2月29日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	43,466	47,757
自己株式	△4,772	△4,772
株主資本合計	76,295	80,586
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	140	203
繰延ヘッジ損益	△39	△36
評価・換算差額等合計	100	167
純資産合計	76,396	80,754
負債純資産合計	124,339	116,331

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)	当第3四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)
売上高	69,199	64,703
売上原価	52,346	51,943
売上総利益	16,853	12,760
販売費及び一般管理費	7,040	3,705
営業利益	9,812	9,054
営業外収益		
受取利息	1	0
受取配当金	12	15
保険解約返戻金	—	32
その他	64	54
営業外収益合計	77	102
営業外費用		
支払利息	0	5
固定資産除売却損	168	93
その他	0	0
営業外費用合計	168	99
経常利益	9,721	9,057
特別利益		
補助金収入	—	100
その他	—	18
特別利益合計	—	118
特別損失		
投資有価証券売却損	—	2
特別損失合計	—	2
税引前四半期純利益	9,721	9,173
法人税、住民税及び事業税	3,947	1,884
法人税等調整額	△956	942
法人税等合計	2,990	2,826
四半期純利益	6,731	6,347

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第3四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	41,419	27,779	—	69,199	—	69,199
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	454	5,707	6,165	△6,165	—
合計	41,422	28,234	5,707	75,364	△6,165	69,199
セグメント利益	7,671	1,691	753	10,117	△304	9,812

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間の内部取引に係る金額です。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っています。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生しません。

当第3四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	35,261	29,442	—	64,703	—	64,703
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	1,303	4,007	5,312	△5,312	—
合計	35,262	30,745	4,007	70,016	△5,312	64,703
セグメント利益	6,984	1,806	561	9,352	△297	9,054

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間の内部取引に係る金額です。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っています。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生しません。